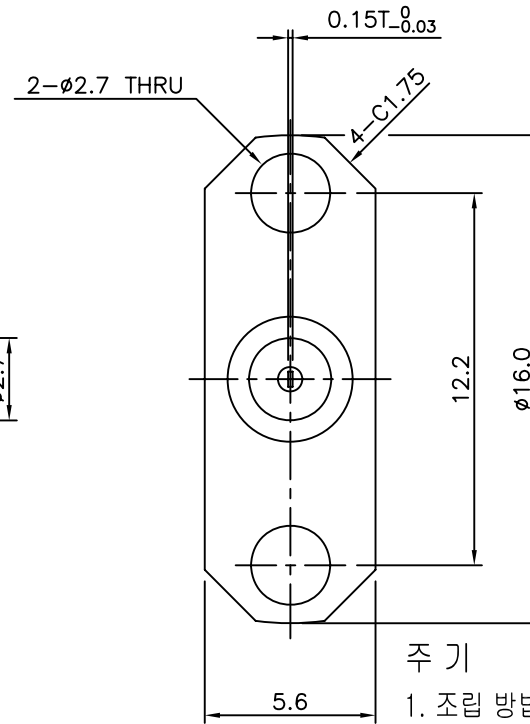
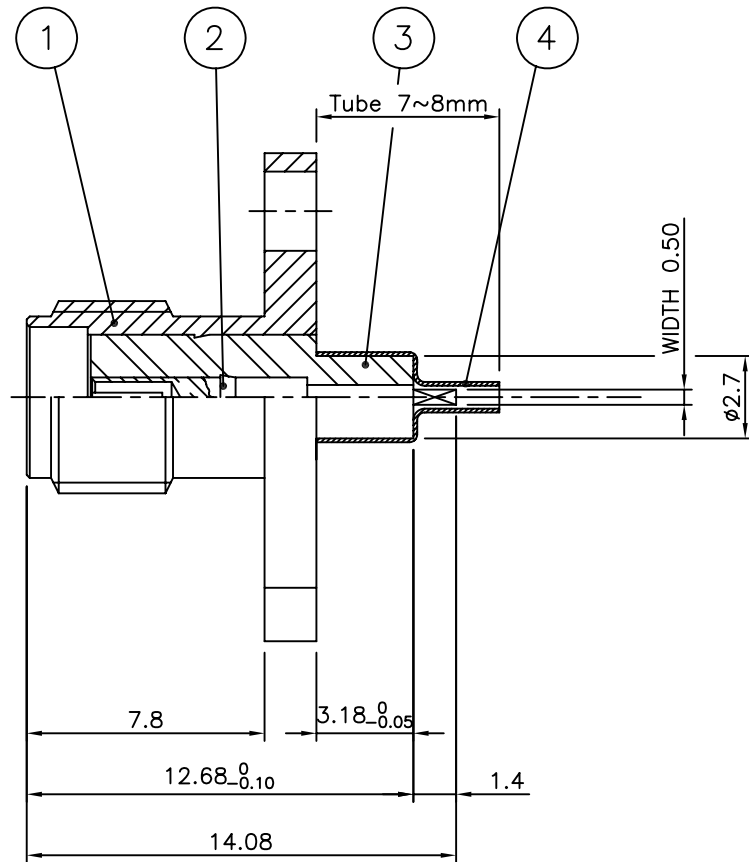
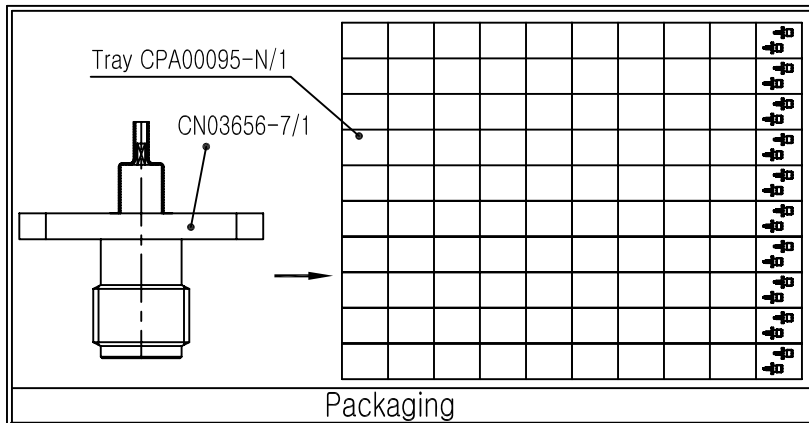


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.11.09.



주 기

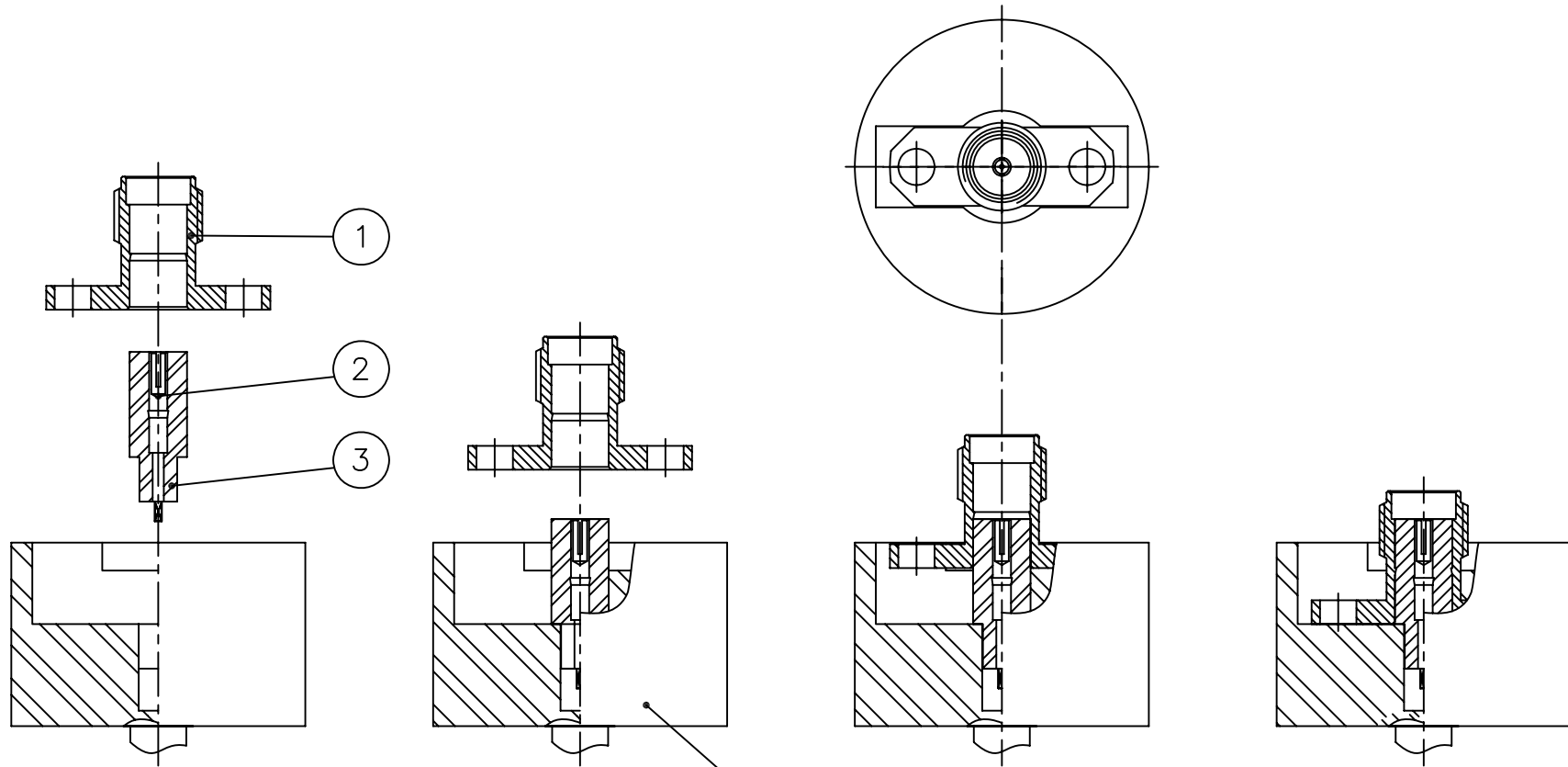
1. 조립 방법 및 조립JIG 2Page 참조 할 것.
2. 완제품 조립 후 SHRINK TUBE를 절연체 위로 수축하여
Tray CODE : CPA00095-N/1 홈 당 제품 2개씩 포장 할 것.



4	SHRINK TUBE	1	—	—	ATU00055-N/1 (ø3.5-BIack)
3	INSULATOR	1	TEFLON	—	DIN02844-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT03781-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD00347-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 11. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM		
	$\pm 1^{\circ}$	CHECKED BY			
MATERIAL	_____	DRAWN BY	C.K.KIM		TITLE SMA50 SOLDER END JS-2H
FINISH	_____	SCALE 4/1	UNIT mm		A4
					DWG NO. CN03656-7/1
					REVISION I R
					SHEET 1 of 1

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.11.09.



조립 방법

1. ②번 PIN과 ③번 절연체를 조립한다.
2. PIN을 조립한 ③번 절연체를 전용 JIG에 가조립한다.
*PIN방향 주의 할 것.
*전용 JIG CODE : CEQ00462-N/1
3. ①번 BODY를 JIG에 놓인 절연체에 올려놓는다.
*지그면과 플렌지 방향을 맞춰 넣을 것.
4. 알맞은 JIG를 이용하여 위에서 눌러 조립한다.
5. 완제품 조립 후 SHRINK TUBE를 절연체 위로 수축한다.